



Lotpaste Delphine 5504HT

INTERFLUX®
ELECTRONICS N.V.



Technische Daten Delphine 5504HT

Ver: 3.11 02-10-15

Seite 1

Halogenfreie Lotpaste mit hohem Schmelzpunkt

Beschreibung:

Delphine 5504HT ist eine no-clean Lotpaste mit hohem Bleigehalt und ist geeignet für Anwendungen, wo ein hoher Schmelzpunkt notwendig ist, z.B. für die Bauteilfertigung.

Die Legierungen mit hohem Bleigehalt sind für manchen Anwendungen noch von der RoHS-Richtlinie ausgenommen und dürfen weiterhin eingesetzt werden.

Die Lotpaste wurde entwickelt um die Lunkerbildung gering zu halten.

Delphine **5504HT** enthält absolut keine Halogene und ist deshalb auch bei kritischen Anwendungsbereichen sehr zuverlässig und bestens geeignet.

Die Lotpaste ist kolophoniumfrei und gibt eine geringere Maschinenverschmutzung und Ofenwartung als kolophoniumhaltige Pasten.

Die Rückstände sind transparent. Testnadeln wie z. B. beim IC-Test oder bei der Flying Probe können leicht durchdringen.



Abgebildetes Produkt kann vom gelieferten Produkt abweichen

Mehr Information:

Produkthandhabung S. 2

Reflow S. 2

Parameterempfehlungen S. 3

Eigenschaften

- Absolut halogenfrei
- Klassifizierung gemäß IPC und EN:
RE LO

Verfügbarkeit

Legierung	Metallgehalt	Körnung	Gebinde
Pb92,5Sn5Ag2,5 (+/- 287-296 °C)	Drucken 91%	Standard Typ 3 (25– 45µ)	500g Dose 1kg–1,2kg–1,3kg –12 Oz. Kartusche andere Gebindegrößen auf Anfrage
Pb88Sn10Ag2 (+/- 268-299 °C)			



Handhabung

Lagerung

Die Lotpaste sollte im geschlossenen Originalgebinde bei einer Temperatur zwischen 3 - 7 °C gelagert werden.

Handhabung

Zur Vermeidung von Kondenswasserbildung Lotpaste vor dem Öffnen langsam auf Raumtemperatur erwärmen lassen. Vor Gebrauch gut aufrühren.

Drucken

Stellen Sie sicher, dass die LP gut gegen die Schablone drückt. Nicht mehr Rakeldruck anwenden als notwendig um eine saubere Schablone zu haben. Ausreichend Lotpaste auftragen, damit die Lotpaste während des Druckens gut rollen kann. Regelmäßig kleinere Mengen frischer Lotpaste beifügen.

Unterhalt

Regelmäßige Reinigungsintervalle der Schablonenunterseite für die Gewährleistung einer kontinuierlichen optimalen Druckqualität festlegen. Dieses Intervall ist von Leiterplatte und den Umgebungsparametern abhängig.

ISC8020 wird empfohlen als Reinigungsmittel für die Schablonenunterseitenreinigung

Wiederholter Gebrauch

Gebrauchte Lotpaste nicht wieder in den Kühlschrank stellen. Dose verschließen und in einem geschlossenen Behälter mit wasserabsorbierendem Material lagern. Vor erneutem Produktionseinsatz die Lotpaste testen.

Sicherheit

Bitte immer das Sicherheitsdatenblatt des Produktes lesen.

Reflow

Wegen des hohen Schmelzpunktes, ist es empfehlenswert den Reflowprozess unter N₂/H₂ - Atmosphäre zu führen.

Eine Peaktemperatur von wenigstens 10°C über der Schmelzzone ist empfehlenswert.



Parameterempfehlungen

Drucken
Geschwindigkeit: 20–120 mm/sec
Rakeldruck: ± 250 g / cm Länge
Unterseitenreinigung: jede 10 LP
Temperatur: 15°C bis 25°C

Bestücken
Klebezeit: > 4 Stunden

I. C.T
Flying Probe testbar
Nadelbett testbar

Handelsname : Delphine 5504HT No-Clean Solder Paste

Haftungsausschluss

Diese Angaben beschreiben ausschließlich die Sicherheitserfordernisse des Produktes und stützen sich nach bestem Wissen auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Da Interflux® Electronics N.V. die vielen Möglichkeiten, unter denen die oben genannten Produkte eingesetzt werden können, weder kontrollieren, noch beeinflussen kann, kann keine Garantie über die Verwendbarkeit gegeben werden. Die Anwender sind jeweils verpflichtet, Tests zur Verwendbarkeit der Produkte für den jeweiligen Anwendungsfall in der eigenen Fertigungsumgebung durchzuführen. Die Daten des oben angegebenen Produktes stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des Produktes im Sinne von Haftungs- bzw. Gewährleistungsvorschriften dar und erfolgen unverbindlich.

Copyright:

INTERFLUX® ELECTRONICS

Die letzte Version dieses Dokumentes finden Sie auf:

www.interflux.com/de

Das Dokument in einer anderen Sprache?:

www.interflux.com